



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUTORIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES

RETIFICAÇÃO

Na publicação da Portaria Susep/Diorg n. 936, de 7 de junho de 2018, publicada no DOU de 11 de junho de 2018, seção 1, página 28, onde se lê: "... na assembleia geral ordinária realizada em 28 de março de 2018:" leia-se: "... na assembleia geral extraordinária realizada em 28 de março de 2018:"

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 35, DE 28 DE JUNHO DE 2018

Estabelece o Processo Produtivo Básico para o produto MÓDULO IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), COM COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), industrializado na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 13 a 16 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52001.101162/2017-12, de 5 de outubro de 2017, resolvem:

Art. 1º Estabelecer o Processo Produtivo Básico para o produto MÓDULO IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), COM COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), industrializado na Zona Franca de Manaus, conforme as seguintes etapas:

- I - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso do componente semicondutor dedicado de alta integração e desempenho (SiP);
- II - moldagem e blindagem em conformidade de contorno;
- III - execução dos sulcos a laser (laser grooving) e pulverização catódica (sputtering);
- IV - singularização de encapsulamentos;
- V - gravação e teste de software;
- VI - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso principal do dispositivo IoT, incluindo a colocação de componente semicondutor (SiP) de alta integração; e
- VII - integração das placas de circuito impresso, subconjuntos e das partes elétricas e mecânicas na formatação do módulo IoT, quando aplicável.

§ 1º Todas as etapas deverão ser realizadas no País e poderão ser realizadas por terceiros.

§ 2º A obrigatoriedade das etapas constantes dos incisos de I a V do caput deve atender ao seguinte cronograma:

Até 31 de dezembro de 2020	2021	2022	De 1º de janeiro de 2023 em diante
Dispensado	40%	60%	80%

§ 3º Fica dispensada o cumprimento da etapa VI do caput desde que uma das duas condições abaixo ocorram:

I - O desenvolvimento do projeto do COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), atendendo aos critérios estabelecidos pela Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, e suas atualizações; ou

II - Sempre que as etapas de I a V seja realizada no País.

Art. 2º UM MÓDULO IoT com COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package) a que se refere o art. 1º deve possuir, dentre outras, as seguintes características:

- I - Capacidade de leitura e controle de dados por intermédio de sensor ou interface elétrica, eletrônica, por radiofrequência, ótica ou mecânica;
- II - Interface de transmissão de dados com acesso à internet ou a Redes LPWA (Low Power Wide Area), por intermédio de interfaces abertas ou proprietárias, ou redes de transmissão de dados públicas ou privadas, de curso ou longo alcance, em frequências regulamentadas ou não;
- III - Capacidade de armazenamento, processamento ou transmissão de dados; e
- IV - Capacidade de autoconfiguração ou programação.

Art. 3º O COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), utilizado no Módulo IoT, é um dispositivo de alta integração e desempenho, classificado na posição 8542.31, que deve possuir, dentre outras, as seguintes funções ou características:

- I - Toda a cadeia de processamento de sinal e funções de comunicação, independentemente das interfaces de rádio escolhidas;
- II - O Processador de aplicação primário (CPU), o processador gráfico (GPU) e o processador de sinais digitais (DSP);
- III - Componentes de memória (volátil e não-volátil) necessários para a operação do CPU, GPU e DSP;
- IV - Circuitos de gerenciamento de energia;
- V - Integrar todos os componentes ativos e passivos encapsulados de forma indivisível, formando um corpo único, como um circuito integrado, montados em uma placa de circuito impresso de alta densidade ("PCBA");
- VI - Ser individualmente anexável à placa principal do Módulo IoT;
- VII - Possuir blindagem dos compartimentos de RF (eletromagnetic interference -EMI / Eletromagnetic Compatibility - EMC);
- VIII - Possuir uma área máxima de 900 mm² e altura máxima de 3,2 mm.

Art. 4º Caso o MÓDULO IoT (Internet das Coisas) não possua componente semicondutor dedicado de alta integração e desempenho (SiP - System-in-Package) deve seguir PPB aplicável, a exemplo do PBB para Placa de Circuito Impresso Montada ou para Bens de Informática Aplicáveis à Telecomunicações, entre outros.

Art. 5º Até 31 de maio de cada ano, as empresas beneficiárias deverão encaminhar à Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, relatório do ano anterior contendo informações referentes à produção dos itens com os benefícios fiscais respectivos e cumprimento dos percentuais previstos nesta Portaria.

Art. 6º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS JORGE
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 36, DE 28 DE JUNHO DE 2018

Estabelece o Processo Produtivo Básico para o produto MÓDULO IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), COM COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), industrializado no País.

OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 16 a 19 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52001.101162/2017-12, de 5 de outubro de 2017, resolvem:

Art. 1º Estabelecer o Processo Produtivo Básico para o produto MÓDULO IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), COM COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), industrializado no País, conforme as seguintes etapas:

- I - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso do componente semicondutor dedicado de alta integração e desempenho (SiP);
- II - moldagem e blindagem em conformidade de contorno;
- III - execução dos sulcos a laser (laser grooving) e pulverização catódica (sputtering);
- IV - singularização de encapsulamentos;
- V - gravação e teste de software;
- VI - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso principal do dispositivo IoT, incluindo a colocação de componente semicondutor (SiP) de alta integração; e
- VII - integração das placas de circuito impresso, subconjuntos e das partes elétricas e mecânicas na formatação do módulo IoT, quando aplicável.

§ 1º Todas as etapas deverão ser realizadas no País e poderão ser realizadas por terceiros.

§ 2º A obrigatoriedade das etapas constantes dos incisos de I a V do caput deve atender ao seguinte cronograma:

Até 31 de dezembro de 2020	2021	2022	De 1º de janeiro de 2023 em diante
Dispensado	40%	60%	80%

§ 3º Fica dispensada o cumprimento da etapa VI do caput desde que uma das duas condições abaixo ocorram:

I - O desenvolvimento do projeto do COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), atendendo aos critérios estabelecidos pela Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, e suas atualizações; ou

II - Sempre que as etapas de I a V seja realizada no País.

Art. 2º UM MÓDULO IoT com COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package) a que se refere o art. 1º deve possuir, dentre outras, as seguintes características:

- I - Capacidade de leitura e controle de dados por intermédio de sensor ou interface elétrica, eletrônica, por radiofrequência, ótica ou mecânica;
- II - Interface de transmissão de dados com acesso à internet ou a Redes LPWA (Low Power Wide Area), por intermédio de interfaces abertas ou proprietárias, ou redes de transmissão de dados públicas ou privadas, de curso ou longo alcance, em frequências regulamentadas ou não;
- III - Capacidade de armazenamento, processamento ou transmissão de dados; e
- IV - Capacidade de autoconfiguração ou programação.

Art. 3º O COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO (SiP - System-in-Package), utilizado no Módulo IoT, é um dispositivo de alta integração e desempenho, classificado na posição 8542.31, que deve possuir, dentre outras, as seguintes funções ou características:

- I - Toda a cadeia de processamento de sinal e funções de comunicação, independentemente das interfaces de rádio escolhidas;
- II - O Processador de aplicação primário (CPU), o processador gráfico (GPU) e o processador de sinais digitais (DSP);
- III - Componentes de memória (volátil e não-volátil) necessários para a operação do CPU, GPU e DSP;
- IV - Circuitos de gerenciamento de energia;
- V - Integrar todos os componentes ativos e passivos encapsulados de forma indivisível, formando um corpo único, como um circuito integrado, montados em uma placa de circuito impresso de alta densidade ("PCBA");
- VI - Ser individualmente anexável à placa principal do Módulo IoT;
- VII - Possuir blindagem dos compartimentos de RF (eletromagnetic interference -EMI / Eletromagnetic Compatibility - EMC);
- VIII - Possuir uma área máxima de 900 mm² e altura máxima de 3,2 mm.

Art. 4º Caso o MÓDULO IoT (Internet of Things - Internet das Coisas) não possua componente semicondutor dedicado de alta integração e desempenho (SiP - System-in-Package) deve seguir PPB aplicável, a exemplo do PBB para Placa de Circuito Impresso Montada ou para Bens de Informática Aplicáveis à Telecomunicações, entre outros.

Art. 5º Até 31 de maio de cada ano, as empresas beneficiárias deverão encaminhar à Secretaria de Políticas Digitais - SEPOD, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e à Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial - SDCI, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, relatório do ano anterior contendo informações referentes à produção dos itens com os benefícios fiscais respectivos e cumprimento dos percentuais previstos nesta Portaria.

Art. 6º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS JORGE
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações